

## RJ45C5E S1U 0.9N4N RL

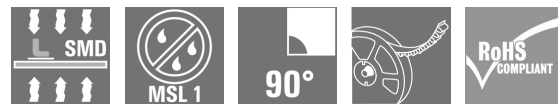
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:

- 90°, liegend (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
- Rasthaken oben und unten (latch up / latch down)
- THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
- Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierten LED's und Schirm-Kontaktfahnen
- Performance Kategorie von Cat.3 bis Cat.6
- Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
- Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603
- Spannungsfestigkeit  $\geq 1500V$  AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3
- Spannungsfestigkeit  $\geq 1500V$  AC (Scheitelwert) oder  $\geq 1500V$  DC gemäß IEC 60603

Eigenschaften und Vorteile:

- Erweiterter Temperaturbereich von  $-40^{\circ}C$  bis  $+85^{\circ}C$ , für maximale Leistungsfähigkeit
- Verstärkte Goldschicht ( $30\mu''$ ) für verbesserten Korrosionsschutz
- Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5e, SMD-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: oben, Schirm tabs: keine, $30...80\mu''$ Ni / $\geq 30\mu''$ Au, LED: Nein, Polzahl: 8, Tape
Best.-Nr.	<a href="#">1455220000</a>
Art	RJ45C5E S1U 0.9N4N RL
GTIN (EAN)	4050118261516
VPE	200 Stück
Verpackung	Tape

## RJ45C5E S1U 0.9N4N RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16,6 mm	Tiefe (inch)	0,654 inch
Höhe	15,19 mm	Höhe (inch)	0,598 inch
Höhe niedrigstbauend	13,41 mm	Breite	16,41 mm
Breite (inch)	0,646 inch	Nettogewicht	0,009 g

## Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	Nennspannung	125 V
Nennstrom	1,5 A	PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	1000 V DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	1500 V DC

## Normen

Steckverbinder Norm	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

## Systemkennwerte

Abgangswinkel	90°	Anschlussart	SMD-Lötanschluss
Anzahl Lötstifte pro Pol	1	Beschaltung	8-adrig
Kategorie	Cat. 5e	Koplanarität	100 µm
LED	Nein	Leistungs-Kategorie	Cat. 5e
Lötstift-Abmessungen	oktogonal	Lötstiftlänge (l)	3,5 mm
Lötstiftposition-Toleranz	± 0,1 mm	Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten
Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss	Polzahl	8
Produktfamilie	OMINMATE Data – Modulare RJ45-Buchse	Raster in Zoll (P)	0,05 "
Raster in mm (P)	1,27 mm	Riegel-Option	oben
Schirm tabs	keine	Schirmmaterial	Kupferlegierung
Schirmoberfläche	vernickelt	Schirmung	Ja
Schutzart	IP20	Steckzyklen	750

## Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA 9T	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	II
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 500	Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	Phosphor-Bronze	Kontaktmaterial	Cu-leg
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Schichtaufbau - Steckkontakt	30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	85 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	85 °C

## Verpackungen

Verpackung	Tape	VPE Länge	370 mm
VPE Breite	363 mm	VPE Höhe	116 mm
Tape-Spulendurchmesser Ø (A)	330 mm	Oberflächenwiderstand	Rs = 10 <sup>9</sup> - 10 <sup>12</sup> Ω

**RJ45C5E S1U 0.9N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

**Zulassungen**

ROHS Konform

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Certificate of Compliance](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

## RJ45C5E S1U 0.9N4N RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

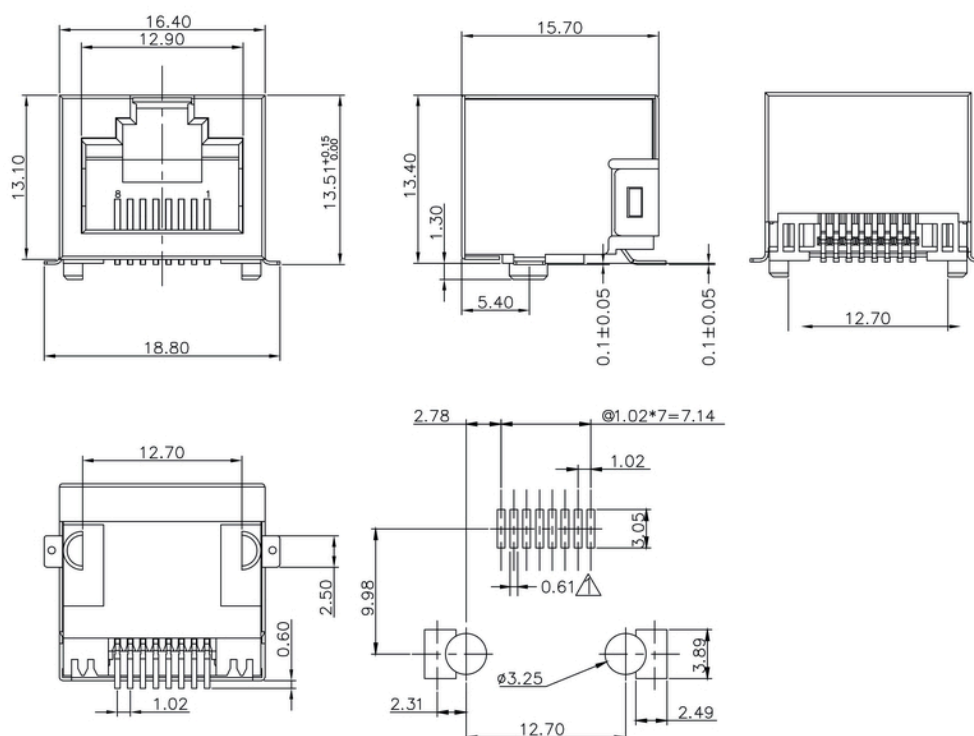
D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßbild



## RJ45C5E S1U 0.9N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

## Produktvorteile



Passend für alle Lötverfahren  
SMT, THT oder THR

RJ45 G1 R1 U3.2 E4 GY/GY TY RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY									
Packaging		TY	Tray in box (manual assembly)						
		RL	Tape on Reel (automated assembly)						
LED		Y/G	Yellow/Green						
		G/Y	Green/Yellow (standard)						
		GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow						
		O/G	Orange/Green						
		R/O	Red/Orange						
		...	... (further combinations possible)						
		N	without LED						
Contact surface thickness		4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"						
EMI tabs (ground fingers)		E	E = with EMI tabs						
		N	N = without EMI tabs						
Solder Pin length		3.2	3.2 mm						
		1.6	1.6 mm						
		D	SMD						
Direction, latch style		U	Horizontal (90°, side entry), latch up						
		D	Horizontal (90°, side entry), latch down						
		V	Vertical (180°, top entry)						
		Y	Diagonal (45°), latch up						
Number of Ports		1	1 Port						
		12; 14; ...	multi ports side by side, Multiport						
		21; 41; ...	multi ports about each other, Multilevel						
Assembly on PCB		R	Through Hole Reflow - THR						
		S	Soldering process: Wave or Reflow soldering						
		T	Surface Mount Technology - SMT						
		T	Soldering process: Reflow soldering						
		T	Through Hole Technology - THT						
		T	Soldering process: Wave						
Performance Category		C5	Category 5						
		C6	Category 6						
		C6A	Category 6A						
		C5e	Category 5e						
		M	10/100 Mbit						
		G1	10/100/1000 Mbit						
		G10	10 Gbit						
		U	Unshielded						
		MP	10/100 Mbit with POE						
		MP+	10/100 Mbit with POE+						

## Legende

Erstellungs-Datum 6. Juni 2024 01:42:42 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**Empfohlenes Reflow-Lötprofil****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt  $\leq +3 \text{ K/s}$ . Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei  $\geq -6 \text{ K/s}$  härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.